데이터 시트

FFP D1/68H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 68, 트레이 (수작업 조립)
주문 번호	2747590000
유형	FFP D1/68H S1 B TY
GTIN (EAN)	4050118896169
수량	75 items
제품 데이터	IEC: / 1.9 A UL: 150 V / 1 A / AWG 30 sol - AWG 30 sol
패키징	트레이 (수작업 조립)

데이터 시트

FFP D1/68H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	5.6 mm	깊이 (인치)	0.2205 inch
높이	14.05 mm	높이 (인치)	0.5531 inch
너비	50.96 mm	폭 (인치)	2.0063 inch
순중량	4.8 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 신호 - 보드 투 보드	결선 유형	절연 변위 결선(IDC)
와이어 결선 방식	IDC 단자	피치(mm)(P)	1.27 mm
피치(인치)(P)	0.050 "	도체 아웃렛 방향	90°/270°
극 수	68	행 수	1
핀 시리즈 수량	2	보호 등급	IP20
볼륨 저항	<25 mΩ	플러그 주기	500
플러깅 힘/폴, 최대	0.6 N	당기는 힘 / 폴, 최대	0.6 N

자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa
절연 저항	≥ 10^{10} Ω	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 기본 재질	구리 합금
접점 재질	구리 합금	접점 표면	Ni/Au
플러그 접점의 레이어 구조	≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-55 °C
작동 온도, 최대	125 °C		

결선에 적합한 컨덕터

결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 30/1, 30/7	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 30/1, 30/7
절연재의 외부 직경, 최소	0.55 mm	절연재 외경, 최대	0.75 mm

IEC 정격데이터

정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	1.9 A	정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	2.3 A
정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	2.5 A	연면거리, 분	0.4 mm
최소간격, 분	0.4 mm		

FFP D1/68H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

UL 1977에 따른 정격 데이터

승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조	정격 전압(UL 1977)(구형)	150 V
정격 전류(UL 1977)(구형)	1 A	AWG 컨덕터, 최소(UL 1977)	30 sol
AWG 컨덕터, 최대(UL 1977)	30 sol		

패키징

패키징	트레이 (수작업 조립)	VPE 길이	190.00 mm
VPE 폭	122.00 mm	VPE 높이	79.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	

분류

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

FFP D1/68H S1 B TY

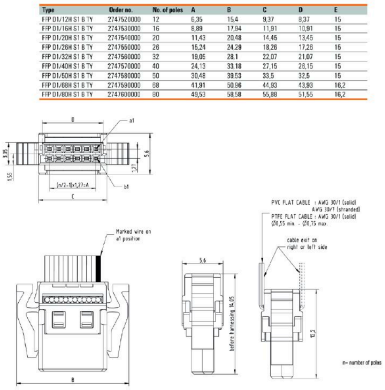
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

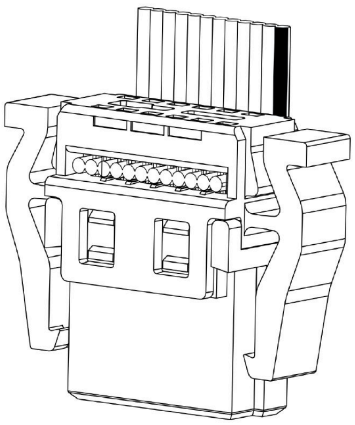
도면

With optional strain relief

Dimensional drawing



상세 도면

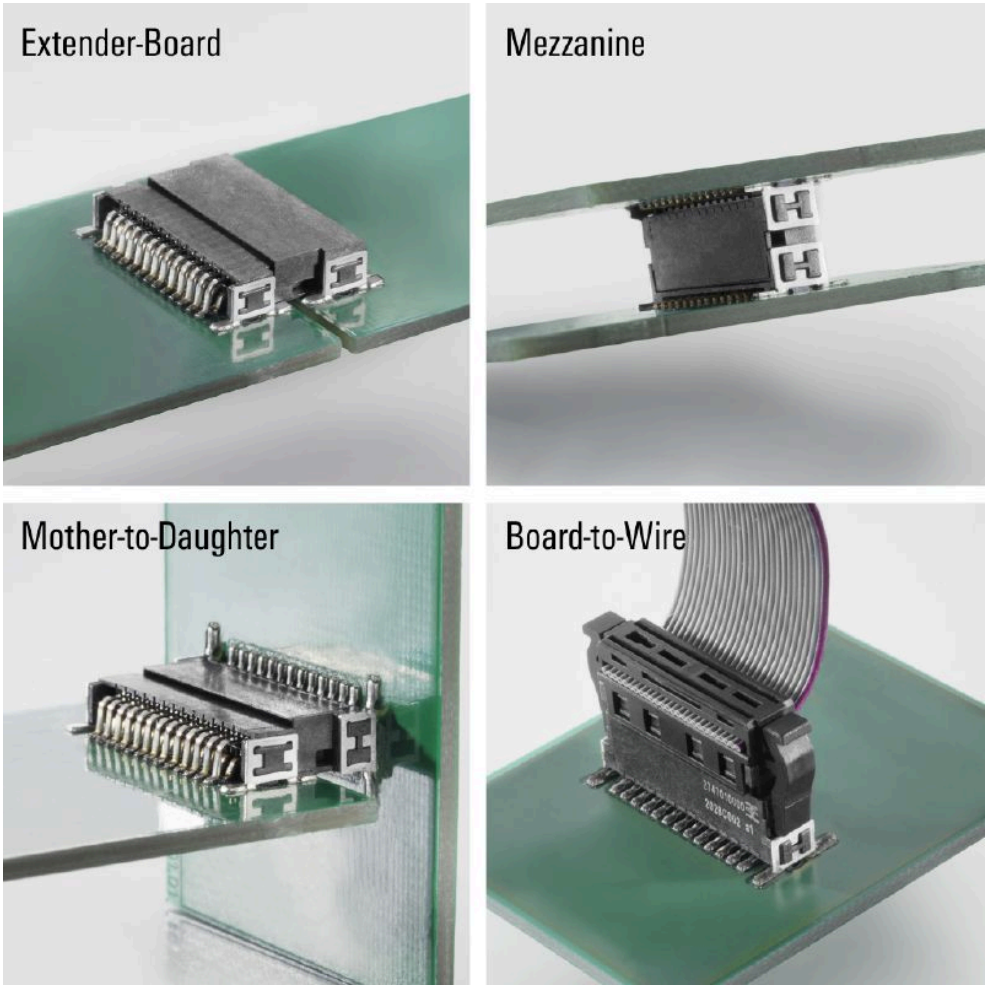


FFP D1/68H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



FFP D1/68H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

FC/FFP - 스트레인 릴리프(액세서리)

OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FC/FFP ZE/68 B BX	버전
주문 번호	2853160000	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 68,
GTIN (EAN)	4064675476030	박스
수량	50 ST	

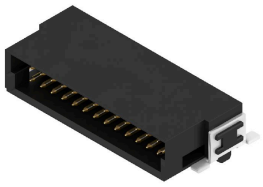
FFP D1/68H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

FMH - 수형 헤더, 보드 결선



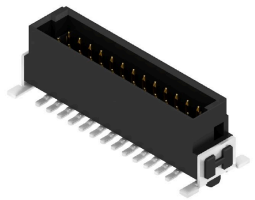
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH S1/68H F1 B RL	버전
주문 번호	2747230000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27
GTIN (EAN)	4064675001027	mm, 극 수: 68, 90°, Tape
수량	560 ST	

FMH1 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 1.75mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH1 S1/68V F1 B RL	버전
주문 번호	2747050000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27
GTIN (EAN)	4064675001188	mm, 극 수: 68, 180°, Tape
수량	280 ST	

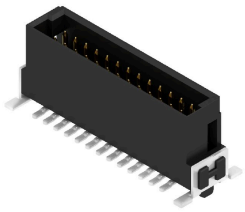
FFP D1/68H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

FMH3 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 3.25mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링
미래 대비형 컨텍트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH3 S1/68V F1 B RL	버전
주문 번호	2747140000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27
GTIN (EAN)	4064675001201	mm, 극 수: 68, 180°, Tape
수량	280 ST	